

PSS BAR 系列

BAR 条自动测试系统 ▶▶▶



产品简介

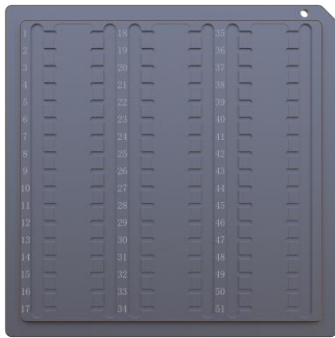
普赛斯 EML BAR 条自动测试机用于 LD 巴条 LIV 曲线, 光谱, 背光自动测量, EA 加电测试, SOA 加电测试。全自动上下料, 支持多种规格料盒上料, 支持多种规格料盒或蓝膜下料。常温、高温双温测试, 高温测试温度可由用户自定。向用户开放测量数据库, 用于后续筛分工序。

产品应用

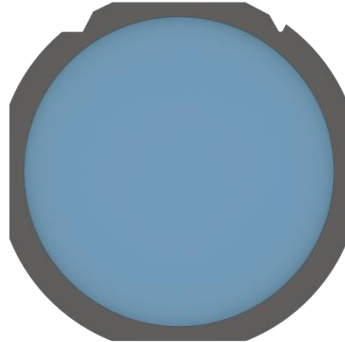
- 设备用于 DFB/EML BAR 条自动测试, 可以实现常温、高温条件下边发射芯片光谱、LIV 参数测试

产品特点

- 支持多种主流规格料盒，全自动上下料，避免转料或人工操作对巴条 chip 造成的报废



料盒

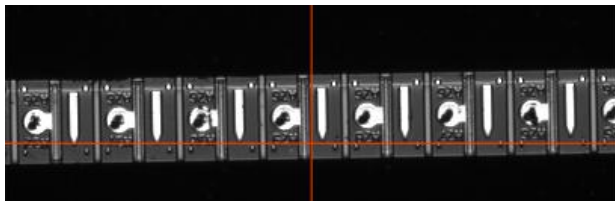


蓝膜

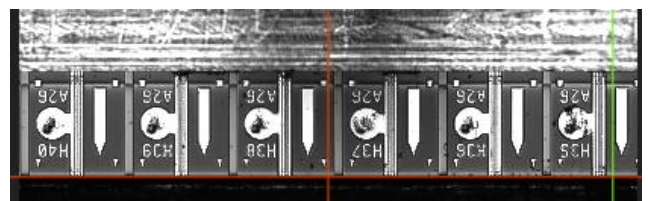


2 寸真空释放盒

- 上下料料盒配磁吸式夹具，支持快速更换不同规格料盒或蓝膜盘
- 支持 BAR 条自动上料、首颗 chip 识别定位，支持 ID 识别、自动测试、自动判断 BAR 条测试结束、自动下料

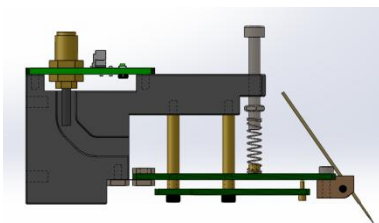


上料相机对焦（自动调整 BAR）

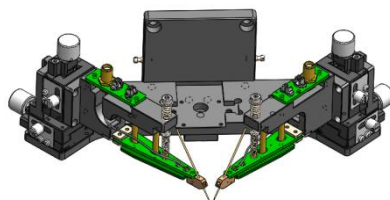


测试相机对焦

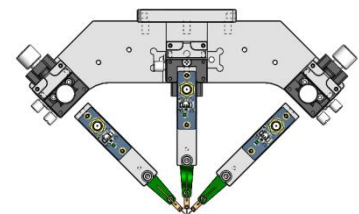
- 吸嘴、探针与 BAR 条接触压力可调
- 支持单探针、双探针、多探针加电的形态



单探针（典型 FP/DFB 测试）

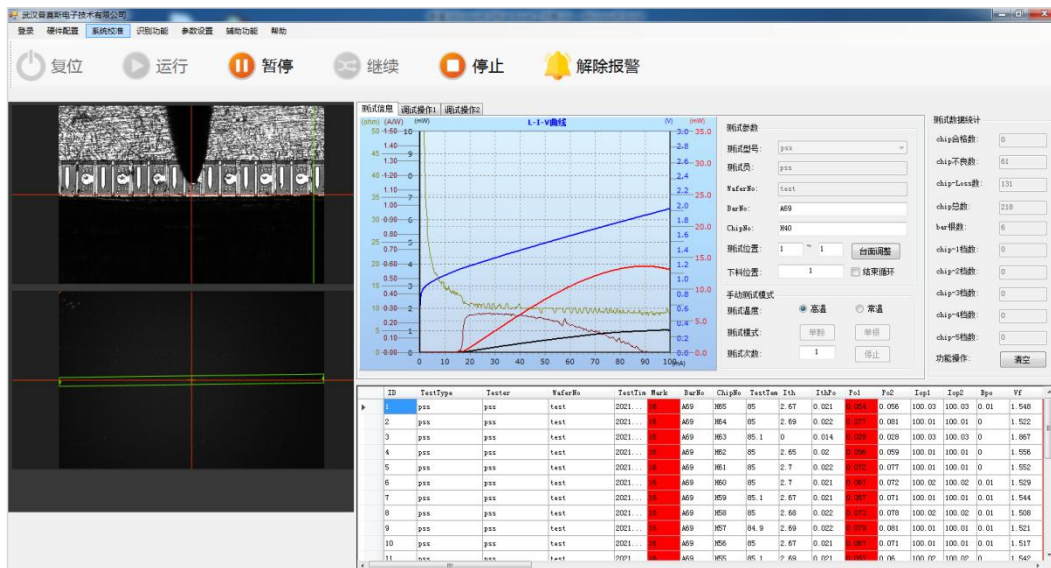


双探针（典型 EML 测试）

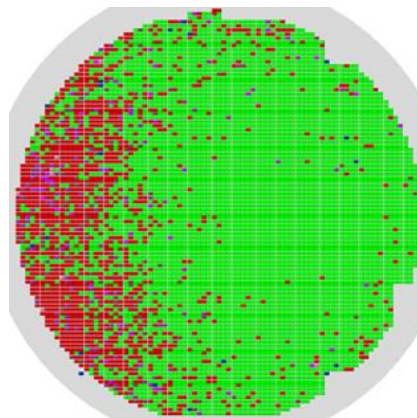


三探针、或其他探针卡的形式

- 支持前光 LIV 曲线、功率、光谱测量，背光功率测量，EA、SOA 相关测试，多参数多条件筛分，尽可能筛选出不良 chip，避免流入后道工序



- 支持 MAP 图绘制，方便用户对 wafer 的性能分布情况分析



- 支持 NG Chip 打点标记，支持简单的芯片外观检查
- 支持常温、高温测试，常温台支持温控
- 多维度可调测量结构，满足用户对不同规格巴条测量需求

技术参数

参数	指标
适用巴条尺寸	长度: 15~30mm 宽度: 0.2~0.5mm, 其他 BAR 条宽度可定制测试台
主要参数	LIV 曲线, Ith, Po, Vf, Im, Rs, SE, Kink, 光谱参数等
LD 驱动电流	范围 0-250mA, 最大可定制到 500mA
电流加电方式	支持连续电流扫描、脉冲输出
前光积分球检测功率	范围 0-500mW
背光电流测量	范围 0-3000uA
EA 电压输出	范围 -5V~+5V
EA 电流测试	范围 -200mA~+200mA
远场发散角测试	范围 ±45°
测试效率 (典型值)[1]	单颗 chip 常温+高温测试时间: LIV+光谱 (1 个点) +ID 识别+机械运动总时间 ≤9s
波长范围	支持定制
高温台温控范围	室温+15~125°C
常温台温控范围	室温~50°C
电源	AC 220V/6A 50Hz